

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2024-026

湖北鼎龙控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨平彩	黄云	
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。此外公司在传统打印复印通用耗材业务领域进行了全产业链布局。

➤ 业务概要

（1）半导体材料业务

①半导体制造用工艺材料

A.CMP制程工艺材料

公司围绕集成电路前段制造中的化学机械抛光（CMP）环节进行布局，致力为客户提供整套的一站式CMP材料及服务。CMP抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，根据SEMI数据，CMP抛光材料在集成电路制造材料成本中占比7%，其中CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液合计占CMP抛光材料成本的85%以上。随着半导体产业规模的增长和制程工艺的进步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和CMP耗材用量将会增加，CMP材料市场将进一步扩大。根据TECHCET最新预测显示，2024年全球CMP耗材市场预计将达35亿美元，至2027年将进一步增长至42亿美元。

公司致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式CMP核心材料及服务，持续提升系统化的CMP环节产品支持能力、技术服务能力、整体方案解决能力，努力成为国内首家也是唯一一家集成电路CMP环节全产品综合性方案提供商。目前，在CMP抛光垫产品方面，公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商，确立CMP抛光垫国产供应龙头地位，相关子公司--鼎汇微电子是国家级专精特新小巨人企业，产品深度渗透国内主流晶圆厂，成为部分客户的第一供应商，被多家晶圆厂核心客户评为优秀供应商；在CMP抛光液产品方面，公司全面开展全制程CMP抛光液产品布局，搭配自主研发磨粒子在客户端持续推广、导入，逐步形成规模销售；在清洗液产品方面，公司铜制程CMP后清洗液持续稳定获得订单，其他制程抛光后清洗液产品结合整体业务战略安排进行开发验证，持续完善业务布局。



图 2.1：鼎龙 CMP 制程工艺材料产品简介

B. 高端晶圆光刻胶

公司着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关，实现“卡脖子”的高端光刻材料产业化，推动高端光刻胶的国产替代进程。晶圆光刻胶是半导体光刻工艺中的关键材料，目前国内在先进的KrF、ArF、EUV光刻胶领域尚未实现大规模量产，而KrF、ArF光刻胶因其覆盖了从0.25 μm到7nm的主要半导体先进制造工艺，是现阶段迫切需要实现国产化技术突破的半导体关键材料，具有重要的战略意义和经济价值。据CEMIA统计，2022年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模为33.58亿元，其中KrF与ArF光刻胶合计占比超过66%；预计到2025年，中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模将达到37.64亿元，其中KrF与ArF光刻胶市场规模将达到25.01亿元。基于公司对高端晶圆光刻胶原料自主合成的技术能力、进口替代类关键光刻胶产品成熟的开发经验、丰富的半导体材料产业化经验和对半导体行业的深厚理解和客户基础，公司开展了高端晶圆光刻胶领域的业务布局，产品开发、验证快速推进，产业化建设同步进行。

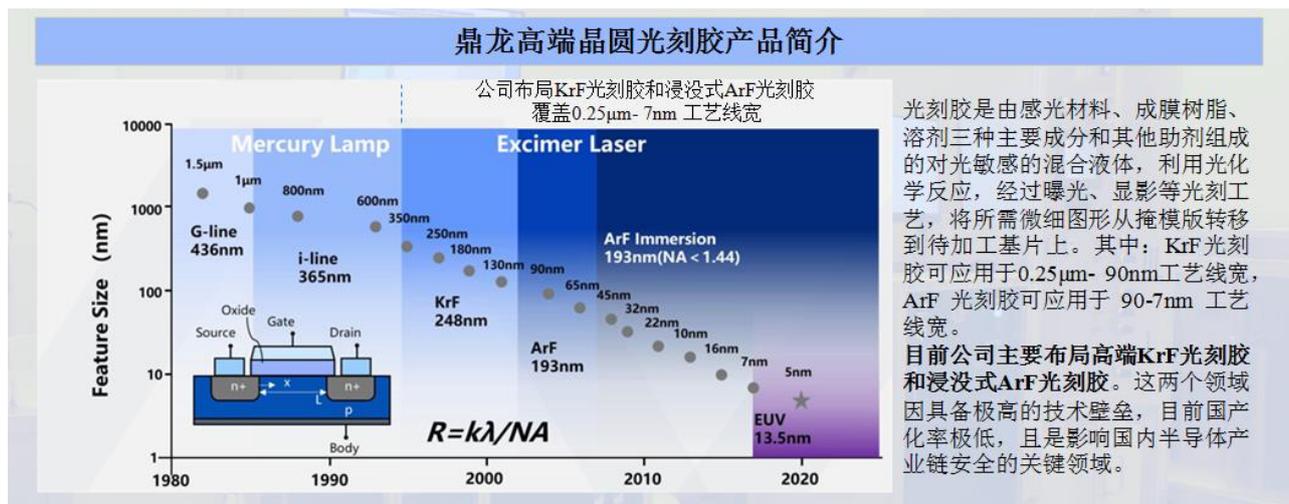


图 2.2：鼎龙高端晶圆光刻胶产品简介

② 半导体显示材料

公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料布局，推出黄色聚酰亚胺浆料YPI、光敏聚酰亚胺浆料PSPI、薄膜封装材料TFE-INK等系列产品。OLED渗透率持续提升，下游笔电、平板、TV等领域应用有望持续放量，带动国内OLED产能持续快速增长，OLED面板产业上游核心原材料供应链自主化程度低，国内替代空间广阔。公司紧抓半导体显示材料产业的战略发展机遇期，布局多款新型显示材料，目前YPI、PSPI、TFE-INK产品已在客户端规模销售，并已成为国内部分主流面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商，确立YPI、PSPI产品国产供应领先地位。同时，公司凭借在OLED显示材料领域多年的积累，对标国际一流共同探索未来显示技术工艺路线及相应材料应用方向，努力成为新型显示前沿技术的创新材料支持商。

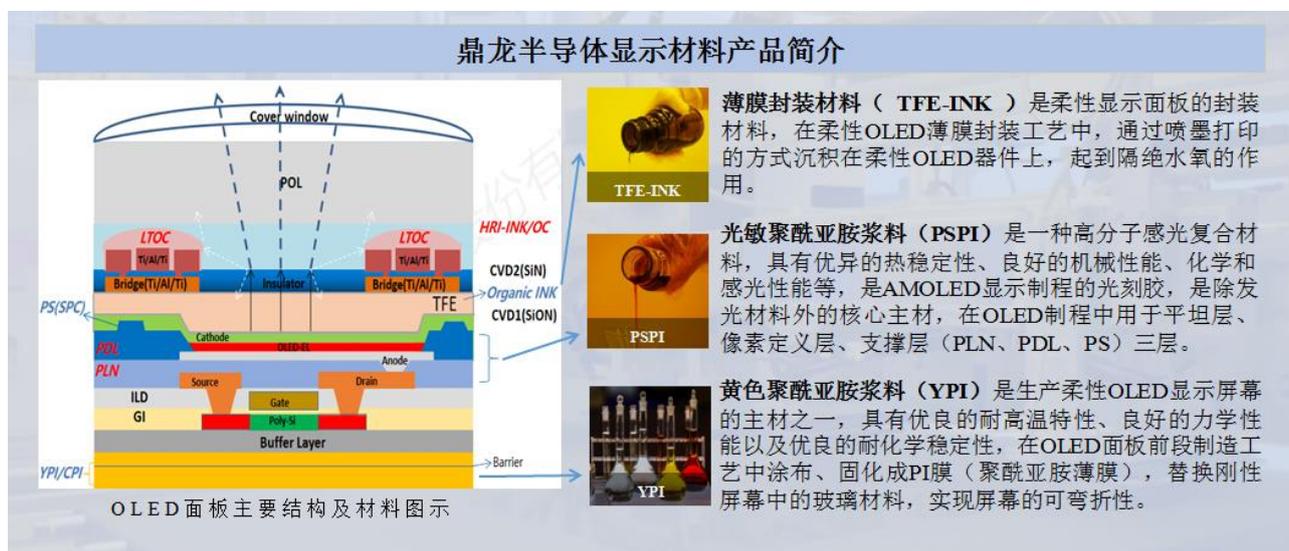


图 2.3：鼎龙半导体显示材料产品简介

③ 半导体先进封装材料

公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的材料产品进行布局，目前重点开发半导体封装PI、临时键合胶等产品。先进封装是超越摩尔定律的关键赛道，同时在全球半导体产业博弈升级的背景下，先进封装有望成为国内半导体制程节点持续发展的突破口。根据Yole数据预测，全球先进封装市场规模将由2022年的443亿

美元，增长到2028年的786亿美元，年复合成长率为10.6%。目前国内先进封装技术处于发展阶段，上游先进封装材料环节较为薄弱，供应链自主化程度低，高端稀缺的关键封装材料基本被海外供应商垄断。公司布局先进封装材料项目，快速推动先进封装材料项目的产品开发验证，力争在“卡脖子”高端封装材料市场中开拓出新的市场空间。

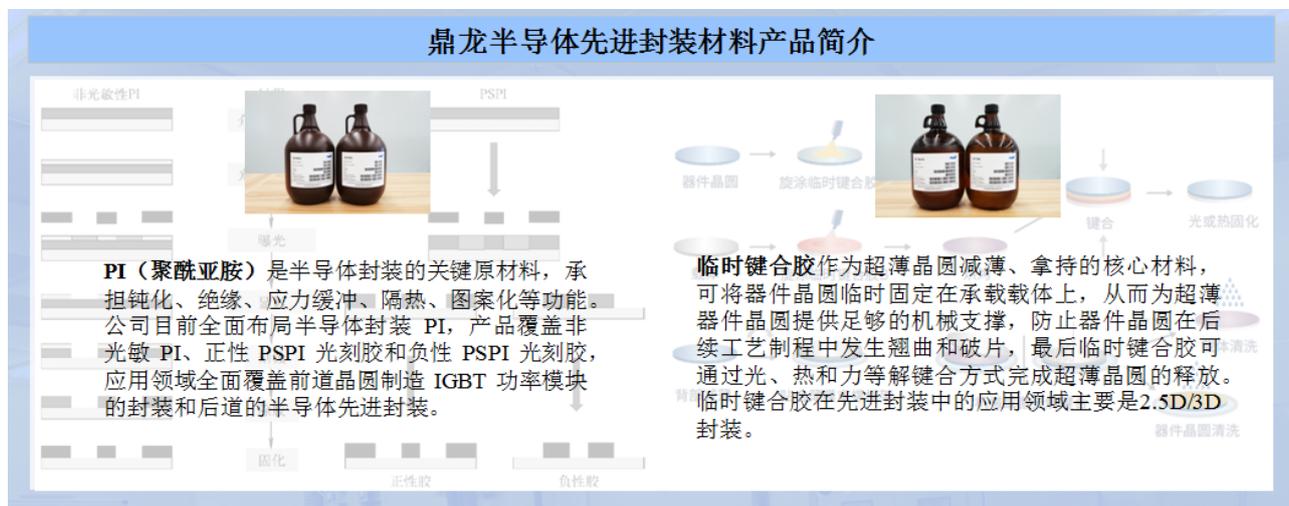


图 2.4：鼎龙半导体先进封装材料产品简介

④集成电路芯片设计 and 应用

在集成电路芯片设计 and 应用领域，公司是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计 and 应用能力的企业，深耕打印复印耗材芯片细分领域 17 年，拥有自主独立知识产权产品，国内领先的公司自有芯片分析实验室；相关子公司一旗捷科技是国家高新技术企业，纳入国家发改委重点布局软件企业，是国家级专精特新小巨人企业。2023 年，公司在稳步发展打印耗材安全加密芯片业务的基础上，加快布局面向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向，同时针对芯片制造环节部分关键技术的“卡脖子”问题，积极在半导体设备配件领域进行布局 and 探索，并已完成前期市场调研及国内主流晶圆厂商的技术研发合作探讨，取得重要技术突破。为公司芯片设计业务的持续转型升级提供新的增长动力。

(2) 打印复印通用耗材业务

公司是产品体系最全、技术跨度最大的打印复印通用耗材龙头企业，以全产业链运营为发展思路，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司的竞争优势地位。生产方面，公司推进产线自动化建设，降本增效，控制质量损失；销售方面，公司通过品牌推广、行业展会、客户服务等方式获取订单，直接销售给国内外客户，同时也通过各大耗材电商平台拓展互联网模式的销售渠道，并严格做好应收账款、存货的管理，控制销售风险。

打印复印通用耗材行业市场竞争模式较为成熟，通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大、产品价低质优的头部企业。目前，公司是全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。彩色碳粉领域，公司是国内唯一掌握四种颜色制备工艺，且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业；再生墨盒领域，子公司绩迅科技是国家工信部再制造墨盒产品认定的首家企业，是国家级专精特新小巨人企业。

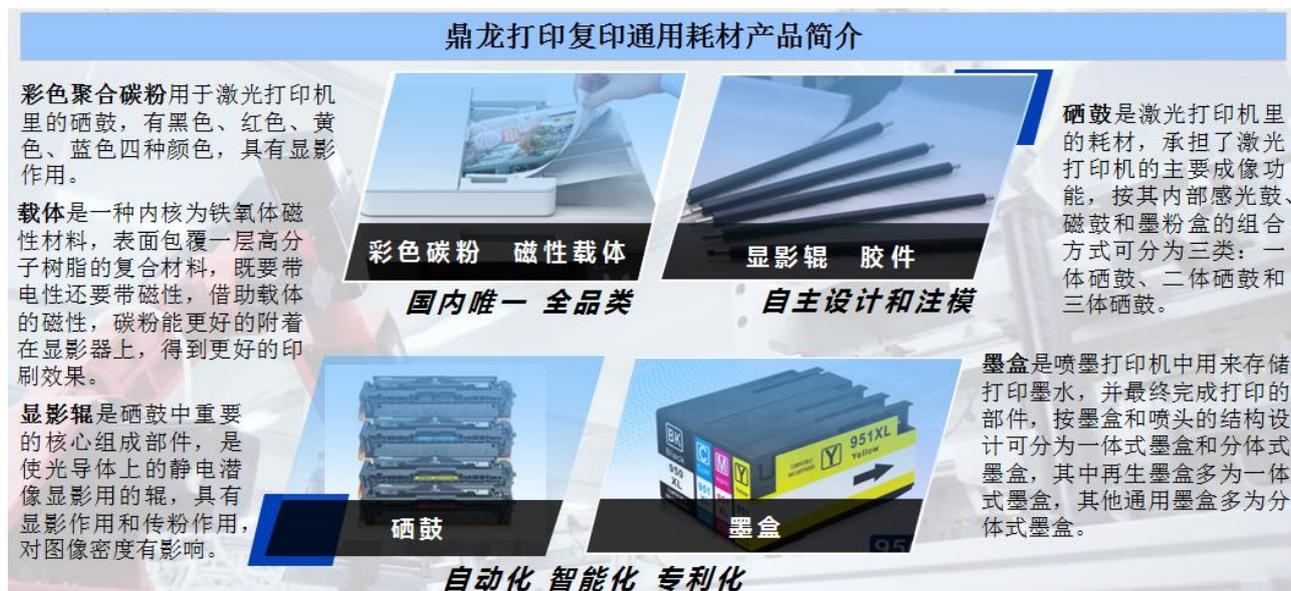


图 2.5：鼎龙打印复印通用耗材产品简介

➤ 本报告期主营业务分析

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。在材料创新平台的搭建过程中，公司一直是在与国际巨头的竞争中学习，在学习中竞争；创新也由开始的追赶创新，向平行创新，到未来引领创新的思路发展。同时，鼎龙也一直坚持“四个同步”：一是坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步；二是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步；三是坚持材料技术创新与人才团队培养同步；四是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步，以此引领企业持续创新发展。

2023年度，公司实现营业收入26.67亿元，同比下降2%（若剔除合并报表范围减少珠海天裕收入因素影响，公司营业收入与上年同期基本持平）；实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比下降43.08%。经营业绩同比变动的原因主要系：（1）公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度，报告期内研发费用金额3.80亿元，同比增长20.20%，研发费用增加影响归母净利润同比减少约3,139万元；（2）因公司仙桃产业园建设影响银行贷款利息支出增加及因汇率波动影响汇兑收益同比下降，两项因素合计影响归母净利润减少约2,965万元；（3）由于参股公司按照权益法核算的长期股权投资收益同比下降，影响归母净利润减少约2,347万元；（4）由于旗捷科技实施员工持股计划影响权益变动并确认股权激励成本，及北海绩迅新三板上市中介费用支出，影响归母净利润同比下降约1,242万元。上述（1~4）项对归母净利润影响合计约9,693万元。此外，公司CMP抛光垫业务上半年度受下游部分客户政策面影响产能较弱而出现销量下滑，公司CMP抛光液、清洗液、潜江软垫的销售规模虽同比增长但尚未盈利，且晶圆光刻胶及先进封装材料业务尚处于研发及市场开拓阶段，以及参股公司长期股权投资减值，均一定程度影响了归母净利润水平。本报告期，公司经营性现金流量净额为5.34亿元，现金流情况良好，为公司各项业务的发展、投入提供了有力支持。

本报告期，公司主要业务进展情况如下：

（1）半导体业务

2023年度，公司半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现营业收入8.57亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），同比增长18.82%，占总营收比重达到32.12%。各产品领域均取得突破，具体如下：

①半导体CMP环节核心耗材一站式布局持续完善，CMP抛光垫业务逐季度恢复情况良好，CMP抛光液、清洗液产品导入、放量进展顺利，在售产品品类不断丰富，CMP环节综合方案解决能力的基础进一步夯实。

A.CMP抛光垫业务：2023年实现产品销售收入4.18亿元，同比下降8.65%；但其中第四季度实现销售收入1.49亿元，环

比增长25.68%，同比增长49.21%，创历史单季收入新高，逐季度呈现明显的复苏和增长的趋势。抛光硬垫方面，国内逻辑晶圆厂开拓取得阶段性成果，制程节点覆盖范围进一步扩大，相关新增型号产品取得批量订单；产品良率、工厂效率进一步提升，品质稳定性也达到更高水平。抛光软垫方面，潜江工厂多个软垫产品已实现批量销售，测试通过的客户增加，产量进入爬坡阶段，包括无纺布类抛光垫也在多家客户的Grinding制程测试通过并取得订单。此外，抛光垫原材料自主化持续突破，自制CMP抛光硬垫用微球完成中试工作，已开始产业化建设，后续将实现CMP抛光硬垫三大核心原材料——预聚体、微球、缓冲垫的全面自产；缓冲垫的开发能力及速度显著提高，数款自研的特殊缓冲垫在部分逻辑晶圆厂客户制程测试中发挥了重要作用，供应链管控效果持续显现。

B.CMP抛光液、清洗液业务：2023年实现产品销售收入0.77亿元，同比增长330.84%；其中第四季度实现销售收入2,890万元，环比增长32.96%，同比增长294.61%，进入快速上量阶段。CMP抛光液方面，全制程产品的市场推广持续进行，搭载自产超纯硅研磨粒子的介电层抛光液在客户端的需求量不断增长、多晶硅抛光液进入国内主流客户供应链体系逐步上量；搭载自产氧化铝研磨粒子的金属栅极抛光液成功导入客户供应链，并满足客户持续上升的订单需求；铜及阻挡层抛光液开始在国内主流客户产线验证，适用于介电层工艺的氧化铈抛光液持续投入开发，争取在2024年取得进一步突破；此外，为满足下游客户扩大的产品需求，公司在仙桃园区完成研磨粒子生产与抛光液生产出货一体整合式的产线模式，使用更大的釜罐容量，保证客户订单的同时，产品质量稳定性更高，2024年第一季度将为多家客户提供验证样品。清洗液方面，除已有的铜CMP清洗液不断形成销售收入外，2023年开发出多款其他制程清洗液以解决客户产线难题，产品导入结果良好，获得一定销售收入。

②半导体显示材料销售增量明显，新品配合客户工艺需求快速开发、验证，在OLED显示关键材料领域的布局日趋完善，行业地位进一步巩固。2023年度，公司显示材料产品销售收入1.74亿元，同比增长267.82%；其中第四季度实现销售收入6,673万元，环比增长17.46%，同比增长174.86%，稳定放量趋势明显。目前，公司已成为国内部分主流面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商，确立YPI、PSPI产品国产供应领先地位，规模化生产的体系能力持续提升，保障产品品质稳定。此外，薄膜封装材料TFE-INK已经通过下游大客户认证，在第四季度导入客户并取得批量订单。供应链管理持续强化，已实现多款核心原材料自主生产，同时积极与上游材料供应商进行合作和布局，优化原料采购成本。在新品开发方面，无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPDF）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK）等半导体显示材料新品也在按计划开发、送样中。此外，2023年度，显示材料相关控股子公司一柔显科技获得湖北省专精特新“小巨人”荣誉称号，体现了公司在该业务领域的创新能力和综合实力。

③高端晶圆光刻胶业务快速推进，产品开发、市场推广、原材料自主化、产线建设等工作同步进行。公司组建了一支专业且高效的技术团队，覆盖配方开发、有机合成、高分子合成、纯化技术、分析评价、工程化等板块，为项目的快速推进提供了有利保障：

A.打造了武汉和潜江双研发中心，武汉本部以配方开发和树脂开发为主，潜江主要布局有机小分子原材料开发（特殊功能单体、光致产酸剂和淬灭剂等）。

B.已建成设备品类齐全的材料分析和应用评价平台，包括液相色谱、气相色谱、液质联用色谱、气质联用色谱、核磁、GPC、ICPMS等材料表征设备和涂胶设备、曝光显影设备、缺陷检测设备、膜厚测试设备等关键应用评价设备。

C.潜江一期小规模光刻胶量产线的建设基本完成，潜江二期300吨光刻胶量产线的建设也于2023年下半年启动。

公司基于二十多年材料开发经验打造了有机合成和高分子合成技术平台，具备自主开发特殊功能单体、树脂、光致产酸剂和淬灭剂等核心原材料的能力，为高端光刻胶的开发奠定了坚实的基础。通过OLED面板光刻胶和先进封装光刻胶积累的丰富光刻胶开发经验，顺利切入晶圆光刻胶领域且快速获得突破。目前公司已布局16支国内还未突破的主流晶圆光刻胶，包括8支高端KrF光刻胶和8支浸没式ArF光刻胶（其中包括4支负显影浸没式ArF光刻胶），均为客户主动委托开发的型号。已完成7支产品的客户送样，其中包括一支极限分辨率KrF光刻胶和一支极限分辨率ArF光刻胶，测试结果都获得了客户的一致认可；其余产品均计划在2024年完成客户送样。

④半导体先进封装材料业务验证进展顺利，体系化建设逐步完善。

A.半导体封装PI方面，公司已布局7款产品，全面覆盖非光敏PI、正性PSPI和负性PSPI，并已送样5款，客户全面覆盖前道晶圆厂和后道封装企业，争取在2024年内完成部分产品的验证并开始导入。此外，公司已建立完整的应用评价体系，确保材料的各项性能指标满足客户需求；供应链自主化持续进行，实现了核心材料聚酰亚胺树脂和部分光敏剂的自主制

备；封装光刻胶项目的产线建设和品管体系建设均已完成，保证客户测试通过后获得订单可实现无缝衔接。

B.临时键合胶产品在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作基本完成，此外有三家以上晶圆厂和封装厂已完成技术对接，根据部分客户的需求正在进行内部验证中。量产方面，临时键合胶产业化建设已实施完成，核心原材料自主可控，具备量产供货能力。

⑤**集成电路芯片设计**和应用：报告期内，公司持续发布多款打印耗材芯片新品，完善耗材芯片产品布局，新业务领域新品按计划开发、测试中；在稳步发展芯片业务的基础上，针对芯片制造环节部分关键技术的“卡脖子”问题，积极在半导体设备配件领域进行布局和探索，公司在该业务方向上，已完成前期市场调研及国内主流晶圆厂商的技术研发合作探讨，并取得重要技术突破。此外，公司上线芯片产品开发及管理的数字化系统，筹建自有可靠性实验室、芯片分析联合实验室等，优化产品设计、提升分析能力，进一步增强公司芯片业务的核心竞争力。

(2) 打印复印通用耗材业务

本报告期，公司打印复印通用耗材板块（不含打印耗材芯片）实现产品销售收入17.86亿元，同比下降8.08%（如剔除珠海天路出表因素影响，公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降4%）。报告期内，打印复印通用耗材各细分领域经营情况如下：

①**彩色碳粉**年出货量虽受终端市场需求及某原装彩粉厂商供应链恢复等因素影响，同比2022年高峰期有所微下降，但下半年环比上半年呈明显改善趋势；此外，公司作为国内少数具备低温定影聚酯碳粉生产能力的企业，报告期内聚酯复印粉销量同比增长260%。

②**硒鼓业务**持续稳定保持盈利，剔除汇兑损益的影响，产品利润同比增长。报告期内，公司重点开展耗材业务的降本增效工作，以提升耗材业务板块的内部综合竞争力，通过珠海硒鼓成品端人力资源整合、组织结构优化，进一步提升人效目标：耗材板块人工成本降幅达10%，人均创收创利均实现不同幅度增长；同时通过持续推进费用管控各项举措，进行采购降本、仓储物流降本及其他运营降本工作，适应盈利增长。

③**墨盒业务**呈现销售数量及销售收入双增长，但受墨盒市场单价下降、绩迅新三板挂牌合规费用支出增加等因素的影响，墨盒业务盈利能力有一定下滑。公司通过不断地降低成本、提高效率，扩大了生产规模和产出能力；通过线上线下客户的全面开发，全方位的市场布局，夯实了市场竞争能力，提高了墨盒的市场占有率。

④**耗材板块应收、存货**规模较大，报告期内重点关注风险管控，对应收、存货、质量损失情况进行事前、事中、事后的全面分析与管控，并配合相关的考核制度化控制，有效降低风险：耗材板块总体存货和应收规模同比下降分别为15%和9.9%。

(3) 管理提升及品牌建设

2023年度，公司获得湖北省制造业企业百强称号、深交所信息披露工作A级评定等，相关新材料项目获得国家部委、省市区等各级政策支持；获授下游重要晶圆客户中芯国际、上海华力的优秀供应商奖项，以及显示面板客户维信诺技术创新奖、天马技术突破奖，展现了公司综合竞争实力及产品影响力。

创新是企业发展的持续动力。2023年度，公司研发投入为3.82亿元，同比增长19.84%，占营业收入的比例为14.33%。同时，公司结合整体业务发展战略持续进行人才团队培养和人员结构优化，以支持各业务板块在研发产出、稳定生产、客户服务等不同阶段的核心需求。

在管理信息化和数字化工厂建设方面，公司搭建了“基础设施-生产现场执行-经营管理与上下游协同-决策支持”的全流程互通互联接口，实现了财务、生产、供应链、仓库、消防、安全等信息化、数据化、流程化，已在部分重要子公司实施并持续推广；建立了“来料→产前处理→过程生产→产后处理→灌装/包装→标贴”的全制程链信息化质量管控链条，形成质量数据池，协助进行业务测和问题预警，实现了全过程的批次可追溯、可谱溯；通过数字化工厂方案的实施，实现内部高效精细管理、优化外部供应链的协同，实现生产的智能化和柔性化等。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,667,127,862.20	2,721,483,697.38	2,721,483,697.38	-2.00%	2,355,886,991.97	2,355,886,991.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,007,881.42	390,026,548.37	390,066,787.24	-43.08%	213,521,066.44	213,428,997.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,342,123.52	348,051,385.99	348,091,624.86	-52.79%	206,593,917.07	206,501,848.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,348,648.61	562,786,027.33	562,786,027.33	-5.05%	3,119,542.34	3,119,542.34
基本每股收益（元/股）	0.24	0.42	0.42	-42.86%	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.41	0.41	-41.46%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	4.94%	8.97%	8.97%	-4.03%	5.64%	5.64%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	6,707,901,850.45	5,620,339,183.70	5,621,937,946.08	19.32%	5,107,312,593.88	5,108,588,277.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,468,459,439.70	4,214,862,140.07	4,214,810,310.29	6.02%	4,027,815,378.34	4,027,723,309.69

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等

单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	546,703,779.03	612,650,361.28	713,166,171.38	794,607,550.51
归属于上市公司股东的净利润	34,733,243.74	61,138,474.20	80,386,387.49	45,749,775.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,990,098.93	47,148,501.66	61,310,421.62	34,893,101.31
经营活动产生的现金流量净额	81,804,891.20	116,161,803.62	165,437,041.70	170,944,912.09

备注：第四季度归属于上市公司股东的净利润环比下降 43%，主要是四季度计提资产减值损失金额所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,741	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	--	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	--	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	--
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
朱双全	境内自然人	14.73%	139,249,514	104,437,135	质押	7,550,000			
朱顺全	境内自然人	14.60%	138,031,414	103,523,560	质押	13,100,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.00%	47,247,446	0	--	--			
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.21%	20,855,830	0	--	--			
招商银行股份有限公司—兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	15,210,002	0	--	--			
上海理成资产管理有限公司—理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	境内非国有法人	1.43%	13,518,242	0	--	--			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高	境内非国有法人	1.30%	12,256,758	0	--	--			

毅晓峰 2 号致信基金						
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	境内非国有法人	1.29%	12,222,086	0	--	--
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	境内非国有法人	1.26%	11,896,850	0	--	--
杨浩	境内自然人	1.06%	10,023,988	0	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	新增	0	0.00%	12,256,758	1.30%
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	新增	0	0.00%	12,222,086	1.29%
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	新增	0	0.00%	11,896,850	1.26%
申万宏源证券有限公司	退出	0	0.00%	6,210,951	0.66%
中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,745,300	0.29%
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	5,256,743	0.56%

注：上表中股东均不涉及转融通出借股份，“期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量”均为其期末持股总数。

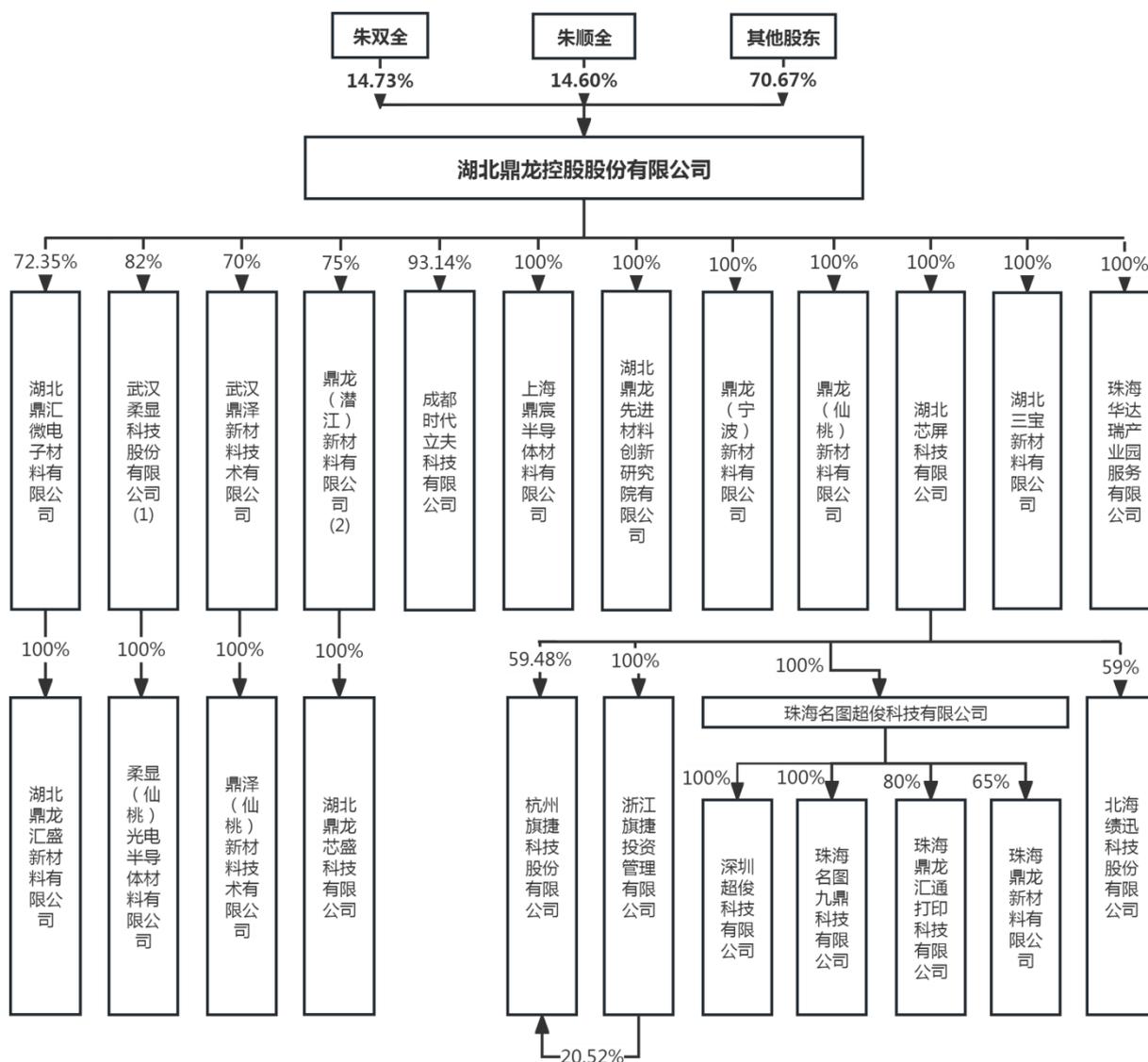
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



备注:

①经 2024 年 3 月 13 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 公司收购控股子公司武汉柔显科技股份有限公司部分股权, 上述交易完成后, 公司持有柔显科技的股权比例将由 70% 变更为 82%。截至本报告披露日, 该事项的在股权托管交易中心的转让变更登记已办理完成。

②经 2023 年 12 月 22 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过, 公司对子公司鼎龙(潜江)新材料有限公司实施增资扩股。上述交易完成后, 公司持有鼎龙(潜江)新材料的股权比例由 100% 变更为 75%。截至本报告披露日, 该事项的员工持股平台已经设立, 鼎龙(潜江)新材料的工商变更登记流程正常进行中。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

具体参见 2023 年年度报告全文。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2024 年 4 月 10 日